

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2023-008

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中京电子”）与江门盈骅光电科技有限公司签署《广东盈骅新材料科技有限公司股权转让协议》。根据转让协议，中京电子以自有资金 1,000 万元人民币受让广东盈骅新材料科技有限公司（以下简称“盈骅新材”）出资额 729,290 元（实缴出资额 729,290 元）对应的股权。本次交易完成后，中京电子成为盈骅新材的股东，持有其 1.4286% 的股权。本次交易价格系综合考虑标的公司历史估值及其产品创新特点，经双方友好协商确定。

盈骅新材主要从事半导体封装基板基材的产品研发、制造与技术服务。盈骅新材长期致力于先进封装领域高性能树脂材料、先进封装基板用 BT 基材以及 FC-BGA 封装基板用 ABF 增层膜的研发以及产业化，其技术研发与创新能力达到国际先进水平，是国内较早开发半导体封装基板用 BT 基材和芯板的企业。盈骅新材的 BT 基材已在 MiniLED 显示、存储芯片、传感器芯片等领域实现批量供货，其 ABF 载板增层膜已经向全球 ABF 载板龙头企业送样，应用于 CPU、GPU、AI 等芯片领域。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在法定信息披露媒体上发布的《关于购买广东盈骅新材料科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-100）。

二、对外投资进展

近日，公司收到盈骅新材的通知，本次股权转让已完成相关工商变更登记手续，变更后盈骅新材股东股权持有情况如下：

股东姓名/名称	股权比例
FUSE KEMMEI	0.6000%
江门盈骅光电科技有限公司	55.5311%
莱富思科技（广州）合伙企业（有限合伙）	7.3057%
长沙国科芯材科技合伙企业（有限合伙）	1.3283%
深圳市高新投创业投资有限公司	1.9371%
广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）	0.1404%
上海湛集商务咨询合伙企业（有限合伙）	5.8113%
颍上县新芯投资基金（有限合伙）	1.9371%
广州同盈投资咨询合伙企业（有限合伙）	0.8498%
广州广华创业投资基金合伙企业（有限合伙）	7.2724%
广州安华共盈创新投资合伙企业（有限合伙）	0.8856%
广州科学城创业投资管理有限公司	1.9371%
广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）	3.8742%
成都市芯元企业管理合伙企业（有限合伙）	0.9687%
共青城龙芯聚能创业投资合伙企业（有限合伙）	2.0000%
共青城力芯创业投资合伙企业（有限合伙）	3.7143%
广州万泽汇联讯精选一号产业投资合伙企业（有限合伙）	1.7143%
东莞市合伟华赢股权投资合伙企业（有限合伙）	0.7640%
惠州中京电子科技股份有限公司	1.4286%
合计	100.0000%

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2023年3月6日